



SPRS TECHNOLOGIES

P/N: STBP125-OR0-E707

Thin Film Planar Filters

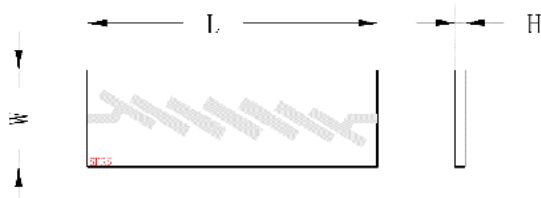
## 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

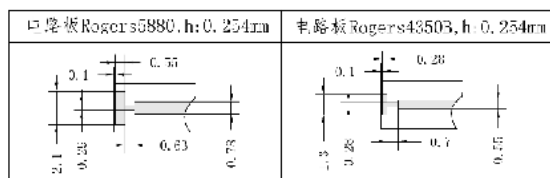
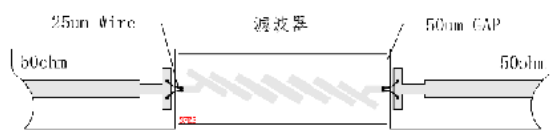
技术要求,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

| 参数                | 最小  | 典型   | 最大   | 单位               |
|-------------------|-----|------|------|------------------|
| 中心频率              |     | 12.5 |      | GHz              |
| 工作频率              |     | /    |      | GHz              |
| 中心损耗              |     | 6.8  | 7.3  | dB               |
| 带内波动              |     | /    |      | dB               |
| 回波损耗              | 12  | 15   |      | dB               |
| 带外抑制@DC-11.9GHz   | 38  | 43   |      | dBc              |
| 带外抑制@13.1-21.0GHz | 38  | 43   |      | dBc              |
| 承受功率              |     |      | 20   | dBm              |
| 工作温度              | -55 |      | +85  | $^\circ\text{C}$ |
| 储存温度              | -55 |      | +125 | $^\circ\text{C}$ |

外形图: L: 6.0, W: 4.0, H: 0.254, 端口居中



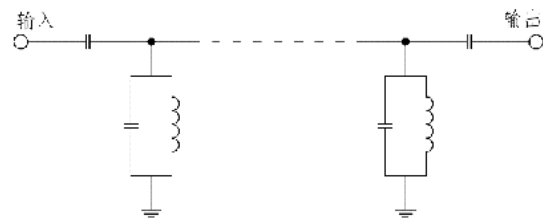
推荐装配图:



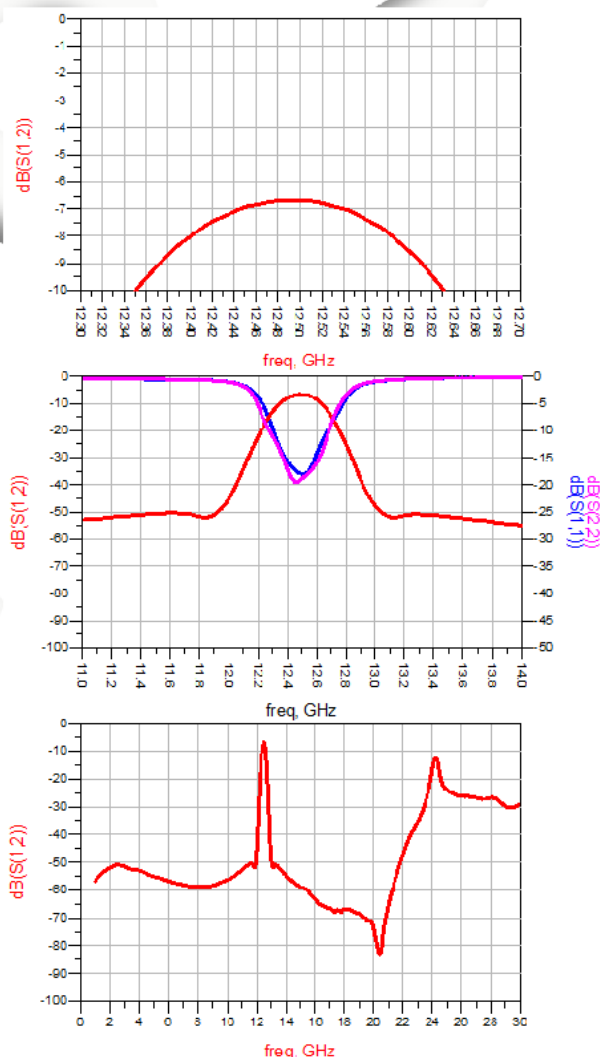
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜钼等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配；

原理图



典型曲线,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



Tel:18349127722

Fax:+86 28-80566718

Email:pengxiaojun@cdsprs.com

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 www.com-mw.com

商城 www.dianzibuy.com

电话 15608095669

邮箱 sales@com-mw.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。